



Steckverbinder > Stecksocket > Speichersockel > SO DIMM-Sockel



DRAM-Typ: **Doppeldatenrate (DDR) 3**  
Stapelhöhe: **5.2 mm [ .205 in ]**  
Modulausrichtung: **Rechter Winkel**  
Anzahl der Positionen: **204**  
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch): **.6 mm [ .024 in ]**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an	Leiterplatte
Steckverbindersystem	Kabel-an-Leiterplatte
DRAM-Typ	Doppeldatenrate (DDR) 3

Konfigurationsmerkmale

Fächeranzahl	2
Anzahl der Kodiermöglichkeiten	1
Anzahl der Reihen	2
Modulausrichtung	Rechter Winkel
Anzahl der Positionen	204

Elektrische Kennwerte

DRAM Spannung	1.5 V
---------------	-------

Signalmerkmale

SGRAM Spannung	1.5 V
----------------	-------

Sonstige Eigenschaften

Klinken-Beschichtungsmaterial	Zinn
Klinkenmaterial	Edelstahl
Modulschlüsseltyp	SGRAM
Auswurftyp	Verriegelung



Auswerfer-Position	Beide Enden
Steckverbinder-Profil	Umgekehrt

Kontaktmerkmale

Kontakt-nennstrom (max.)	.5 A
Speichersockeltyp	Speicherkarte
Kontaktgrundmaterial	Kupferlegierung
PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial	Gold
Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs	Gold (Au)
Beschichtungsdicke des Steckbereichs	.254 µm[10 µin]

Klemmenmerkmale

Einführungstyp	Cam-In
Anschlusstyp (an Leiterplatte)	Oberflächenmontage

Montage und Anschluss-technik

Steckverbinderbefestigungs-Typ	Leiterplattenmontage
Leiterplatten-Halterungstyp	Lötstift
Gegensteckführungstyp	Umgepolte Verschlüsselung
Leiterplattenhalterung	Mit

Gehäusemerkmale

Gehäusematerial	Hochtemperatur-Thermoplast
Gehäusefarbe	Schwarz
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)	.6 mm[.024 in]

Abmessungen

Stapelhöhe	5.2 mm[.205 in]
Reihenabstand	8.2 mm[.322 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
---------------------------	---------------------------

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Leistung
----------------------	----------

Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
----------------------	----------

Verpackungsmerkmale

--	--



Verpackungsmenge	20
Verpackungsmethode	Montage halbfester Einsatz

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Compliant
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Compliant
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2024 (241) Does not contain REACH SVHC
Halogengehalt	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
Lötfähigkeit	Reflow solder capable to 260°C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



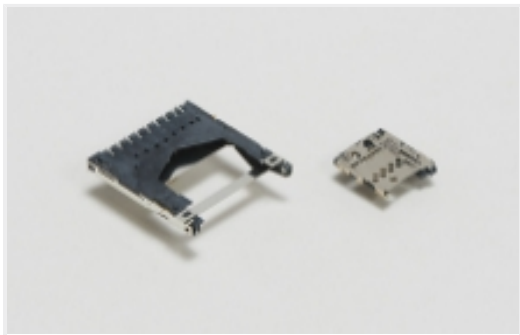
Auch serienmäßig | RAYCHEM RVS



Muffen und Kabelanschlüsse(4)



RJ45 Steckverbinder(1)



SD-Karten-Steckverbinder(2)



SO DIMM-Sockel(13)

Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilennr.:CAT-D48-ST273  
DEUTSCH Massive Kontakte

TE Teilennr.:CAT-D487-W416  
DEUTSCH DT Keilschlösser

TE Teilennr.:DT06-2S  
PLG, 2P, GRY, N

TE Teilennr.:DT04-2P  
REC, 2P, GRY, N

TE Teilennr.:206070-8  
CABLE CLAMP KIT #17

TE Teilennr.:281934-2  
SINGLE WIRE SEAL

TE Teilennr.:CAT-AM71-CH8172  
AMP SUPERSEAL 1,5MM,  
STECKVERBINDERGEHÄUSE

Dokumente

Produktzeichnungen  
SEMI-HARD TRAY DDR3 204P 5.2H RVS Au0.25  
Englisch

CAD-Dateien  
3D PDF  
3D  
Kundenmodell  
ENG\_CVM\_CVM\_2013290-2\_B\_c-2013290-2-b.2d\_dxf.zip  
Englisch  
Kundenmodell  
ENG\_CVM\_CVM\_2013290-2\_B\_c-2013290-2-b.3d\_igs.zip  
Englisch  
Kundenmodell  
ENG\_CVM\_CVM\_2013290-2\_B\_c-2013290-2-b.3d\_stp.zip  
Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den allgemeinen Verkaufsbedingungen zu.



Datenblätter/Katalogseiten

DDR3 DIMM Sockets Flyer 6-1773454-7 05/09

Englisch

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Englisch